



2023年11月22日

各 位

会 社 名 旭ダイヤモンド工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 片岡 和喜
(コード番号 6140 東証プライム)
問合せ先 執行役員管理本部長 小浦 雅美
T E L (03) 3222 - 6311

(訂正)「2024年3月期第2四半期決算説明会資料」の一部訂正について

本日、公表しました「2024年3月期第2四半期決算説明会資料」について、記載内容の一部に誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。

記

1. 訂正理由

「2024年3月期第2四半期決算説明会資料」の一部に記載の誤りがありましたので、訂正を行うものです。

2. 訂正箇所

<15 ページ> 地域別売上高 及び 構成比見通し (連結)

【訂正前】中国 「電子・半導体」向けを中心に関連工具の販売が増加

【訂正後】中国 「電子・半導体」向けを中心に関連工具の販売が減少

<25 ページ> 資本政策および株主還元

【訂正前】自己株式取得 2百万株 (17億円) 7月に取得完了 11月に消却予定

【訂正後】自己株式取得 2百万株 (17億円) 7月に取得完了 11月に消却

3. 添付資料

訂正後の資料を添付しております。

以 上

2024年3月期 第2四半期

決算説明会

2023/11/22



旭ダイヤモンド工業株式会社

01

2024年3月期第2四半期決算の概要

02

2024年3月期の見通し

03

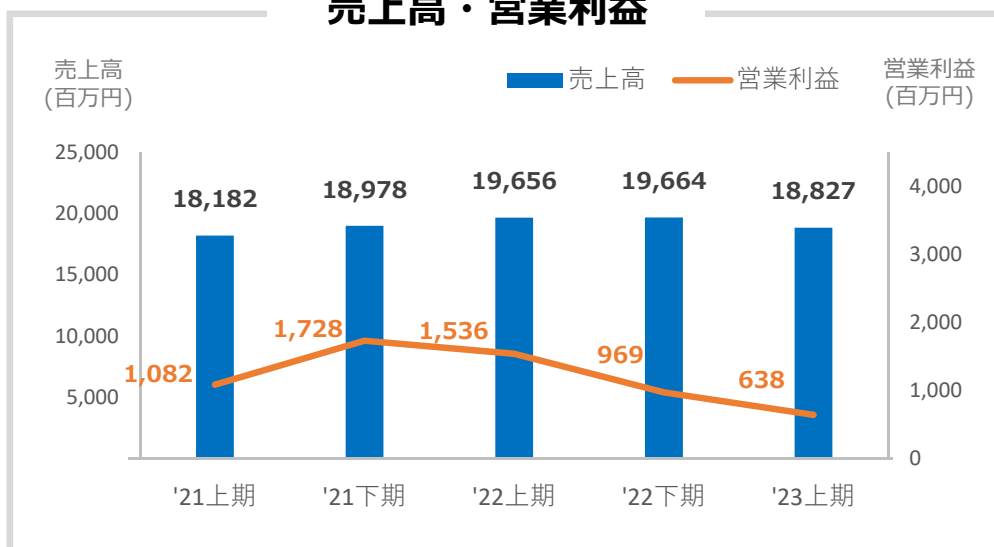
中期経営計画の進捗

決算概要（連結）

単位：百万円

	'23年3月期		'24年3月期			
	上期実績 '22/4-9	百分比 %	上期実績 '23/4-9	百分比 %	前年同期 増減額	前年同期 増減率%
売上高	19,656	100.0	18,827	100.0	▲828	▲4.2
営業利益	1,536	7.8	638	3.4	▲897	▲58.4
経常利益	2,129	10.8	1,215	6.5	▲913	▲42.9
親会社株主に 帰属する四半期純利益	1,549	7.9	1,269	6.7	▲280	▲18.1
1株当たり純利益(円)	28.13	-	24.21	-	▲3.91	-

売上高・営業利益



営業利益(対前年同期増減)

減少要因

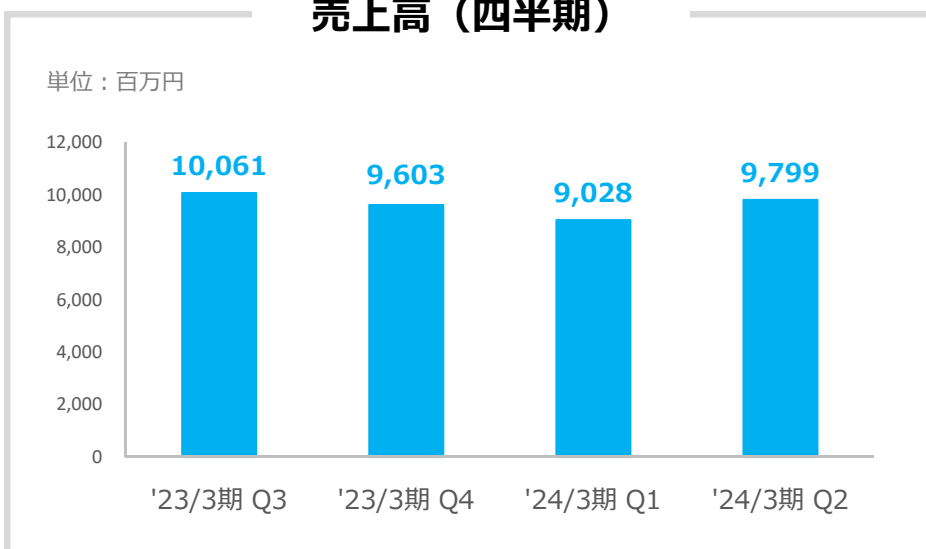
- 売上減少の影響 553百万円
- 工場再編費用他製造経費
及び販管費の増加 400百万円

四半期別実績推移（連結）

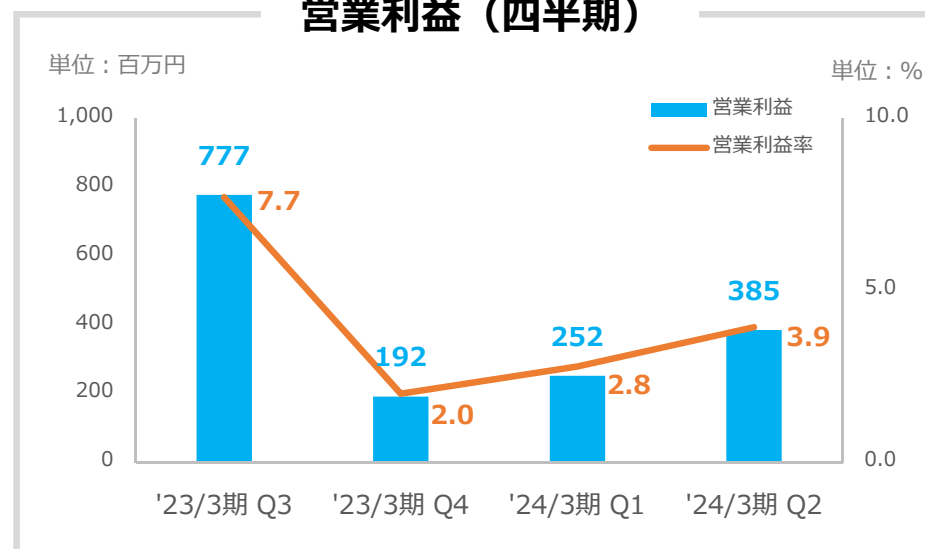
単位：百万円

	'23年3月期				'24年3月期			
	第3四半期		第4四半期		第1四半期		第2四半期	
	実績	百分比%	実績	百分比%	実績	百分比%	実績	百分比%
売上高	10,061	100.0	9,603	100.0	9,028	100.0	9,799	100.0
営業利益	777	7.7	192	2.0	252	2.8	385	3.9
経常利益	900	9.0	245	2.6	556	6.2	659	6.7
親会社株主に 帰属する四半期純利益	647	6.4	568	5.9	532	5.9	737	7.5

売上高（四半期）



営業利益（四半期）

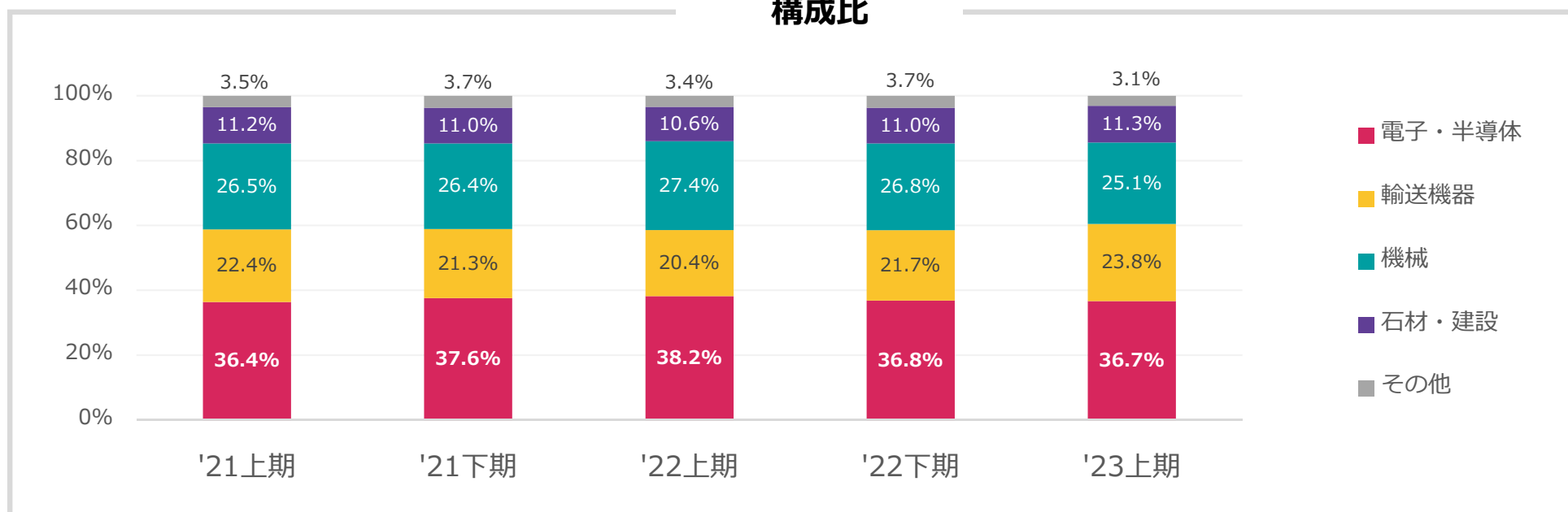


業界別売上高 及び 構成比 (連結)

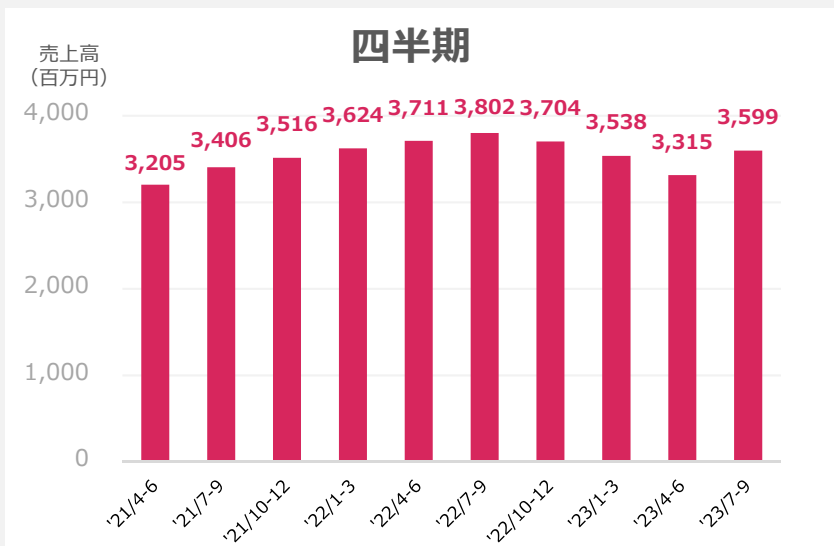
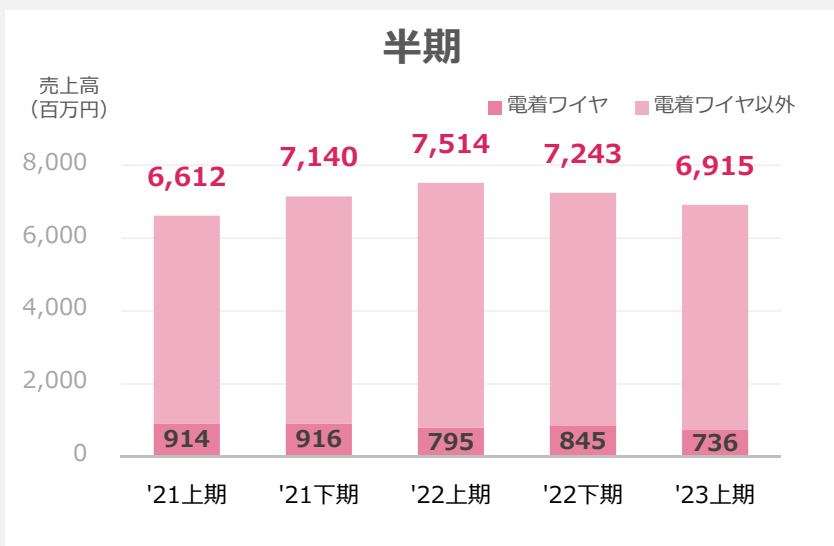
単位：百万円

	'23年3月期				'24年3月期			
	上期実績 '22/4-9	構成比%	下期実績 '22/10-'23/3	構成比%	上期実績 '23/4-9	構成比%	前年同期 増減額	前年同期 増減率%
■ 電子・半導体	7,514	38.2	7,243	36.8	6,915	36.7	▲ 599	▲8.0
■ 輸送機器	4,010	20.4	4,271	21.7	4,469	23.8	459	11.5
■ 機械	5,377	27.4	5,263	26.8	4,733	25.1	▲ 644	▲12.0
■ 石材・建設	2,077	10.6	2,161	11.0	2,125	11.3	47	2.3
■ その他	677	3.4	724	3.7	584	3.1	▲ 92	▲13.7
合計	19,656	100.0	19,664	100.0	18,827	100.0	▲ 828	▲4.2

構成比



業界別売上高：①電子・半導体（電着ダイヤモンドワイヤ含む）



半導体・電子部品

デジタル機器の需要低迷と、
設備投資抑制で販売が減少

FPD（フラットパネルディスプレイ）

主要販売先の需要低迷で販売が減少

伸線

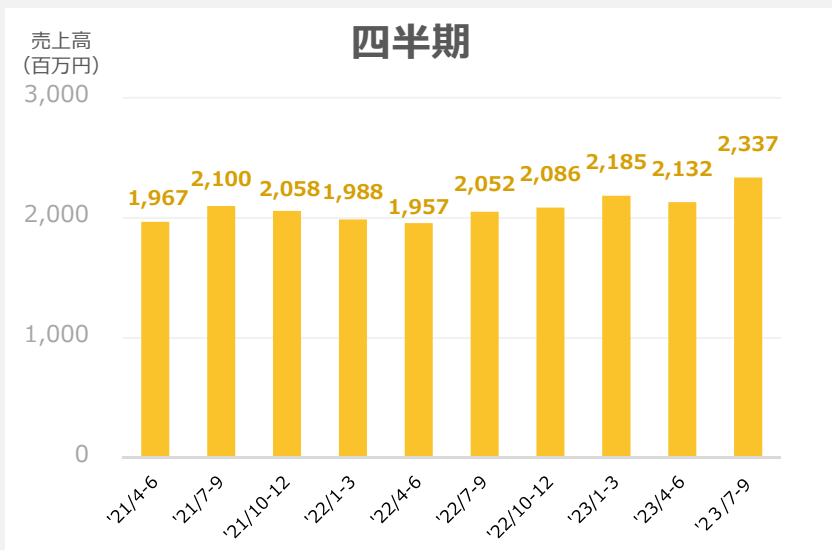
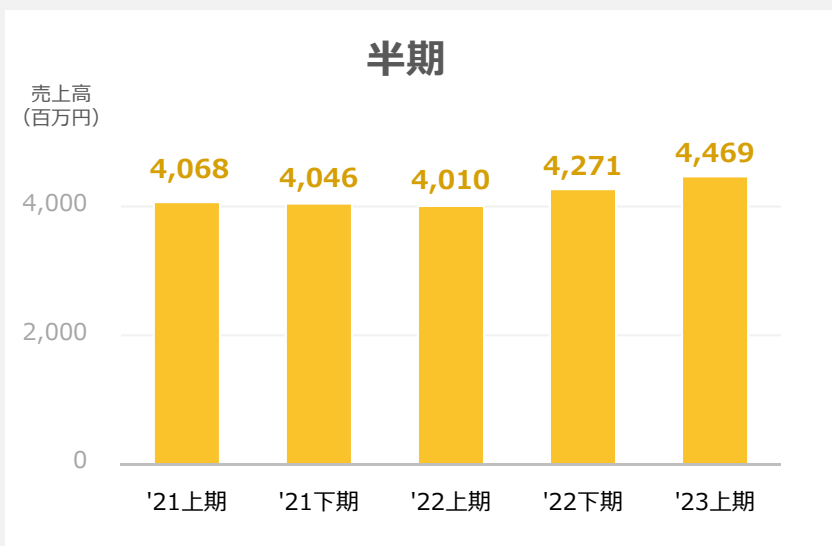
半導体の需要低迷で販売は微減

電着ダイヤモンドワイヤ

パワー半導体用SiC向けは増加したものの、
全体で販売は減少

※SiC:炭化ケイ素（シリコンカーバイト、エスアイシー）

業界別売上高：②輸送機器



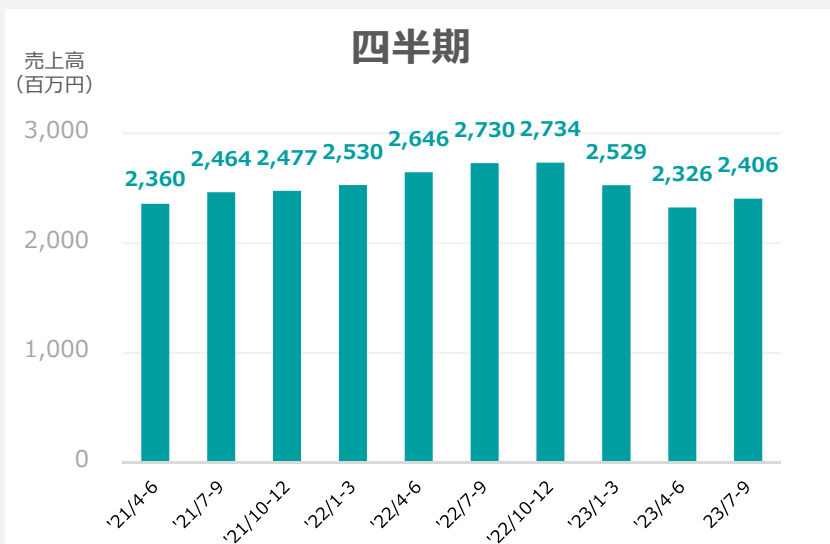
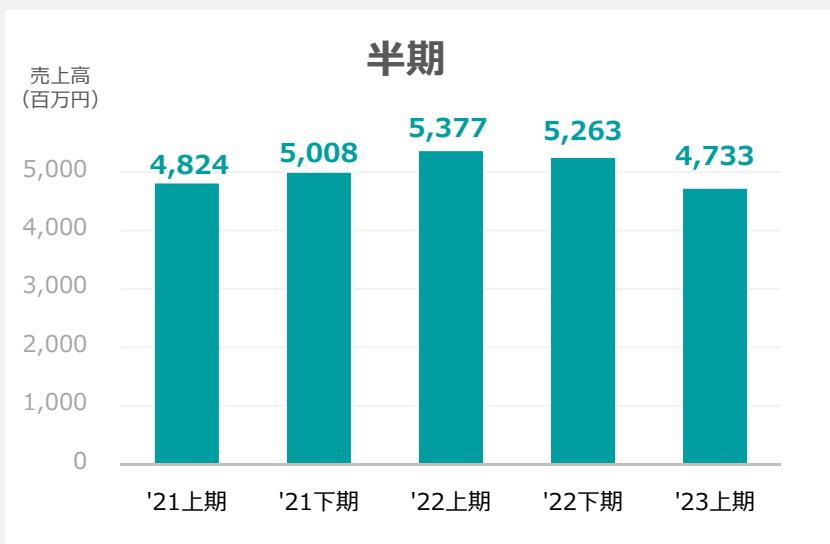
自動車

半導体不足の解消による自動車生産の回復で、
関連工具の販売が増加

航空機

需要の回復が進み、関連工具の販売が増加

業界別売上高：③機械



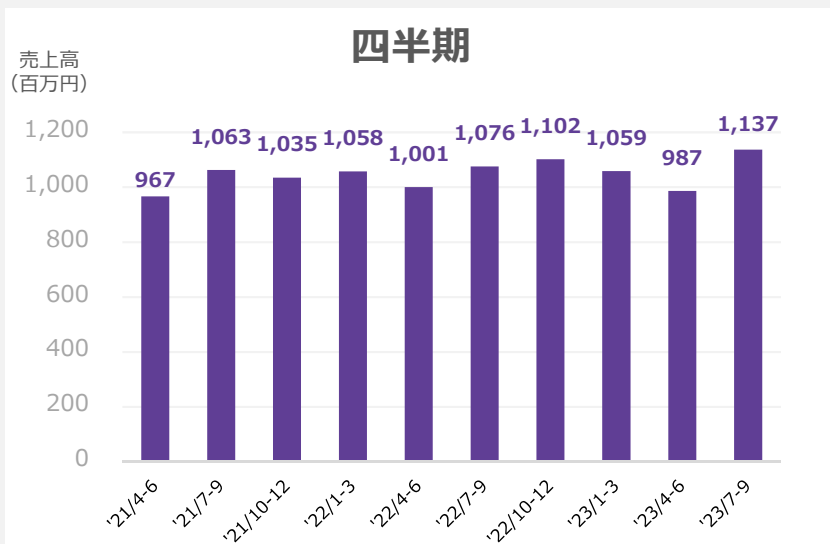
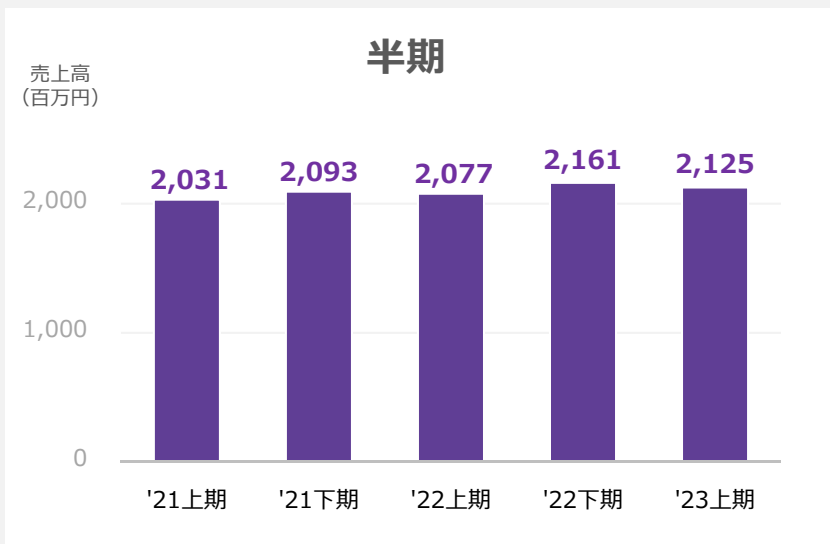
軸受

工作機械などの需要低迷により、
軸受メーカーへの販売が減少

超硬工具

工作機械などの需要低迷により、
超硬工具メーカーへの販売が減少

業界別売上高：④石材・建設



資源探査

海外市場が堅調に推移し、販売は増加

国内建設

高速道路の補修や解体工事等を中心に、
関連工具の販売は増加

流通商品(ポータブルカッタ)

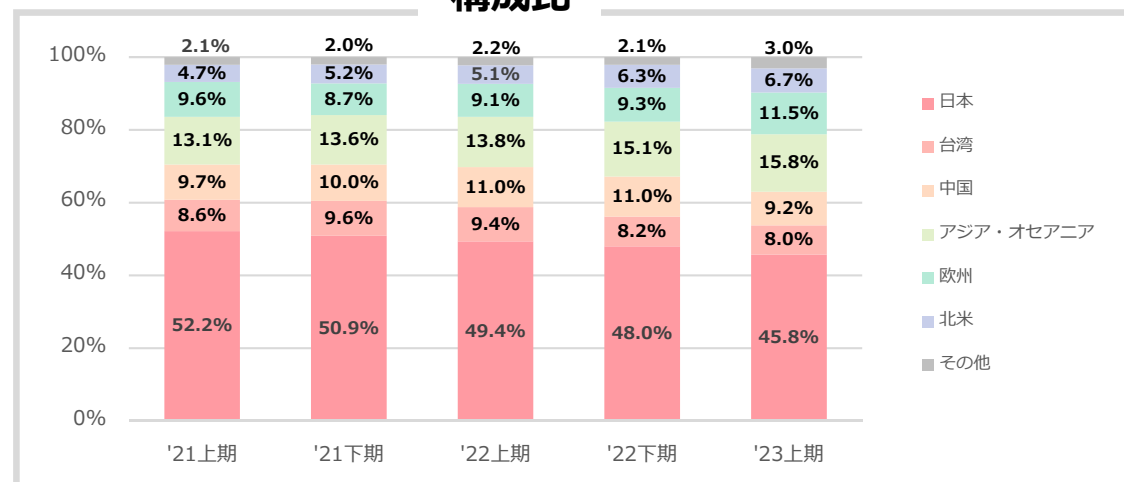
国内外の需要低迷により、販売は減少

地域別売上高 及び 構成比 (連結)

単位：百万円

	'23年3月期				'24年3月期			
	上期実績 '22/4-9	構成比%	下期実績 '22/10-'23/3	構成比%	上期実績 '23/4-9	構成比%	前年同期 増減額	前年同期 増減率%
■ 日本	9,711	49.4	9,468	48.0	8,615	45.8	▲1,095	▲11.3
■ 台湾	1,850	9.4	1,604	8.2	1,513	8.0	▲336	▲18.2
■ 中国	2,167	11.0	2,153	11.0	1,741	9.2	▲425	▲19.6
■ その他アジア・オセアニア	2,711	13.8	2,965	15.1	2,966	15.8	255	9.4
■ 欧州	1,785	9.1	1,820	9.3	2,164	11.5	379	21.3
■ 北米	1,010	5.1	1,234	6.3	1,254	6.7	244	24.2
■ その他	421	2.2	417	2.1	570	3.0	149	35.6
海外計	9,945	50.6	10,195	52.0	10,212	54.2	266	2.7
合計	19,656	100.0	19,664	100.0	18,827	100.0	▲828	▲4.2

構成比



日本

「電子・半導体」、「機械」などの主力業界の
販売が減少

中国

「電子・半導体」を中心に販売が減少

欧州・北米

「電子・半導体」、「輸送機器」を中心に
販売が増加

連結貸借対照表

単位：百万円

資産の部	'23年3月末	'23年9月末	増減
現金及び預金	16,375	13,897	※1 ▲2,478
受取手形及び売掛金	10,059	10,321	262
たな卸資産	7,220	7,955	734
有形固定資産	25,061	25,949	887
無形固定資産	190	378	187
投資有価証券	12,861	12,354	▲507
その他	2,407	2,251	▲155
資産合計	74,177	73,108	▲1,069

負債の部	'23年3月末	'23年9月末	増減
支払手形及び買掛金	1,477	1,460	▲17
未払法人税等	503	510	6
退職給付に係る負債	5,151	3,198	※2 ▲1,953
その他	4,161	4,513	352
負債合計	11,295	9,683	▲1,612

純資産の部	'23年3月末	'23年9月末	増減
純資産合計	62,882	63,425	542
負債純資産合計	74,177	73,108	▲1,069

※1 自己株式2百万株の取得を1,725百万円で実施いたしました。

※2 単体の退職金制度の改定により、退職給付に係る負債が1,813百万円減少しました。

01

2024年3月期第2四半期決算の概要

02

2024年3月期の見通し

03

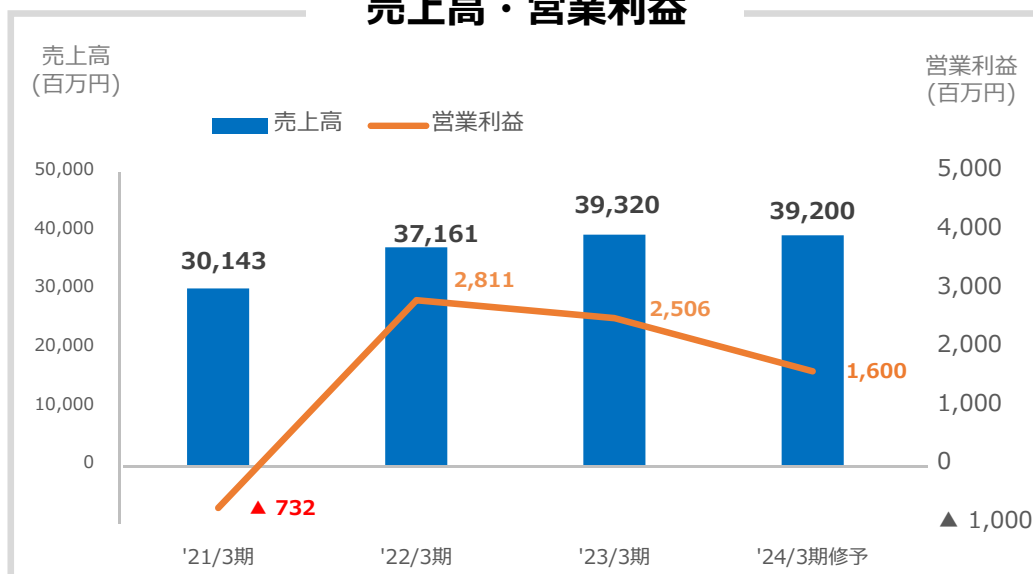
中期経営計画の進捗

見通し概要 (連結)

単位：百万円

	'23年3月期 通期実績	百分比%	'24年3月期 通期予想	百分比%	前年同期 増減率%
売上高	39,320	100.0	39,200	100.0	▲0.3
営業利益	2,506	6.4	1,600	4.1	▲36.2
経常利益	3,275	8.3	2,400	6.1	▲26.7
親会社株主に 帰属する当期純利益	2,765	7.0	2,000	5.1	▲27.7

売上高・営業利益



営業利益(対前年同期増減)

減少要因

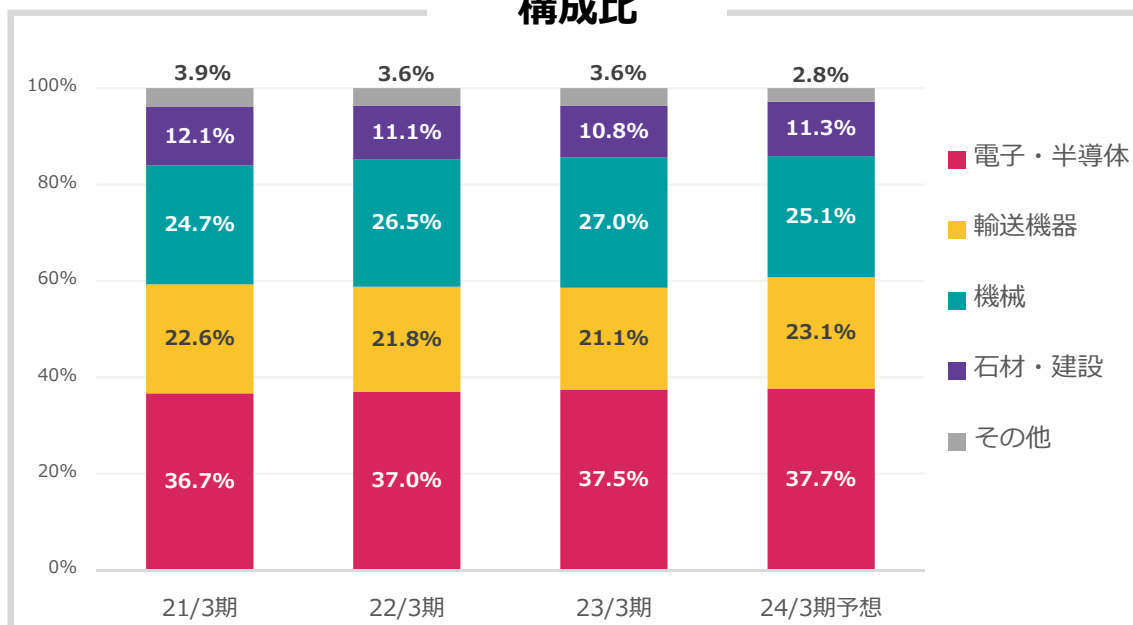
- 減価償却費の増加 100百万円
- 工場再編費用他製造経費
及び販管費の増加 1,080百万円

業界別売上高 及び 構成比見通し (連結)

単位：百万円

	'23年3月期 通期実績	構成比%	'24年3月期 通期予想	構成比%	前年同期 増減率%
■ 電子・半導体	14,757	37.5	14,770	37.7	0.1
■ 輸送機器	8,282	21.1	9,050	23.1	9.3
■ 機械	10,640	27.0	9,850	25.1	▲7.4
■ 石材・建設	4,239	10.8	4,440	11.3	4.7
■ その他	1,401	3.6	1,090	2.8	▲22.2
合計	39,320	100.0	39,200	100.0	▲0.3

構成比



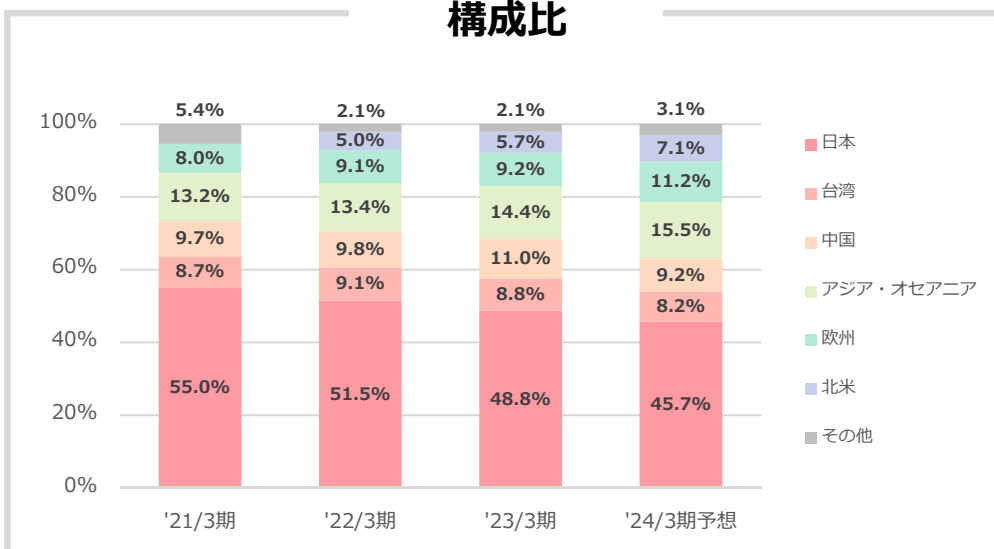
- **電子・半導体**
パワー半導体向けの工具が増加
- **輸送機器**
自動車生産が堅調で増加
- **機械**
工作機械の市場低迷で減少
- **石材・建設**
補修工事、解体工事等が堅調で増加

地域別売上高 及び 構成比見通し (連結)

単位：百万円

	'23年3月期 通期実績	構成比%	'24年3月期 通期予想	構成比%	前年同期 増減率%
■ 日本	19,179	48.8	17,900	45.7	▲6.7
■ 台湾	3,454	8.8	3,200	8.2	▲7.4
■ 中国	4,320	11.0	3,600	9.2	▲16.7
■ その他アジア・オセアニア	5,676	14.4	6,100	15.5	7.5
■ 欧州	3,605	9.2	4,400	11.2	22.0
■ 北米 [※]	2,244	5.7	2,800	7.1	24.7
■ その他	838	2.1	1,200	3.1	43.0
海外計	20,141	51.2	21,300	54.3	5.8
合計	39,320	100.0	39,200	100.0	▲0.3

構成比



日本

「輸送機器」向けが増加するものの
「電子・半導体」「機械」向け関連工具の販売が減少

中国

「電子・半導体」向けを中心に関連工具の販売が減少

欧州・北米

「電子・半導体」「輸送機器」を中心に販売が増加

01

2023年3月期第2四半期決算の概要

02

2023年3月期の見通し

03

中期経営計画の進捗

▼ 「VISION2030」で目指す当社のあるべき姿 ▼

世界のモノづくりを支えるグローバルニッチトップメーカーへ

実現に向けた3つの要素

ブランド力の強化

市場浸透による拡販

成長分野/得意分野に注力

経営リソースの効果的な活用

先見的な製品開発

顧客ニーズの一步先へ

事業成長に向けた3つの重点施策

1

半導体注力

2

経営基盤強化

3

リソースの最適化

半導体注力

電子半導体セグメントに経営資源を集中させ、高収益&業界のトップを目指す

▶ 開発・製造

- 脱炭素にも貢献する需要拡大中のパワー半導体用SiC向け工具の開発
- 工場再編による増産体制の構築
- 生産効率及び原価率の改善

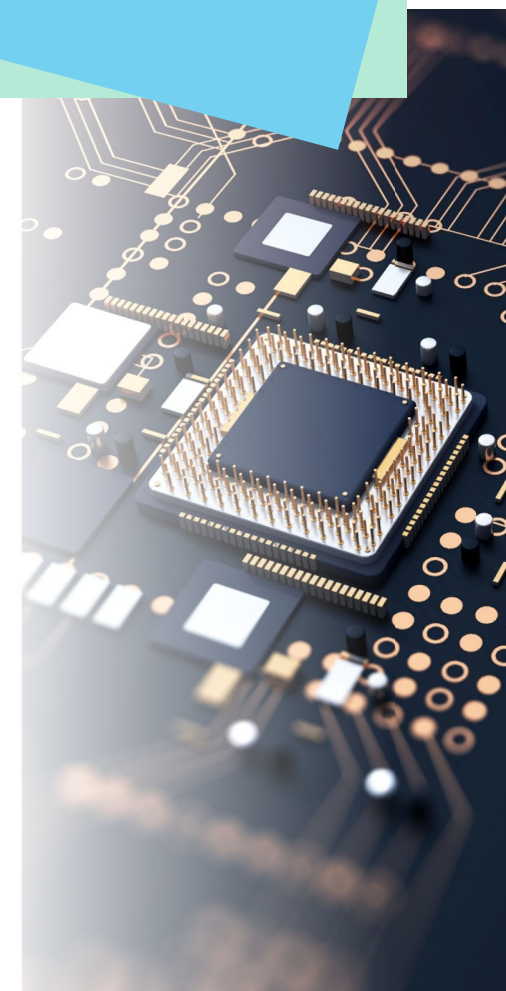
▶ 販売

- 高収益製品の拡販に注力
- 展示会の活用

▶ 電子半導体セグメントの主力5製品状況

	23年度上期	23年度見込
5品目合計	22年上比101%	22年比110%
(Si)	22年上比80%	22年比87%
(SiC)	22年上比255%	22年比235%

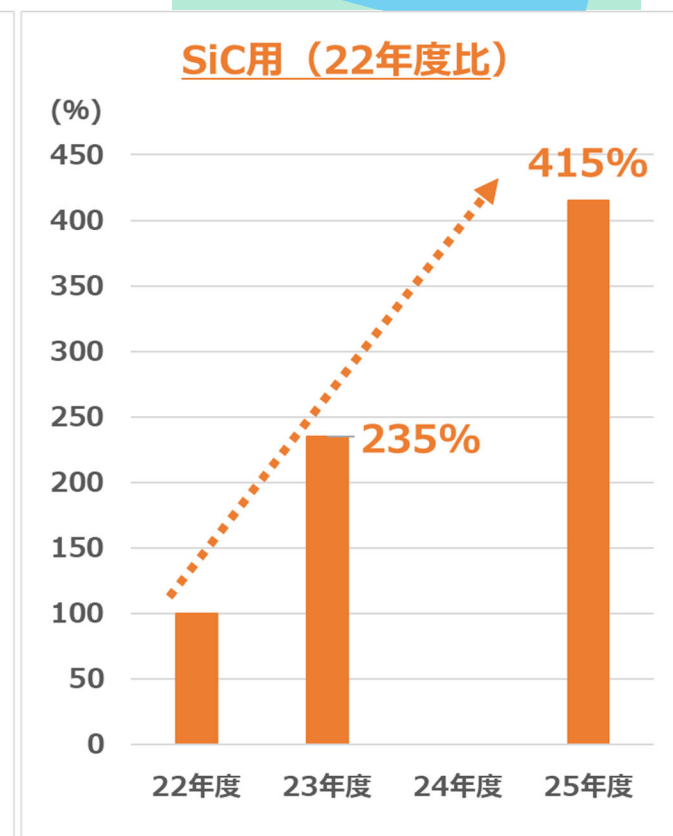
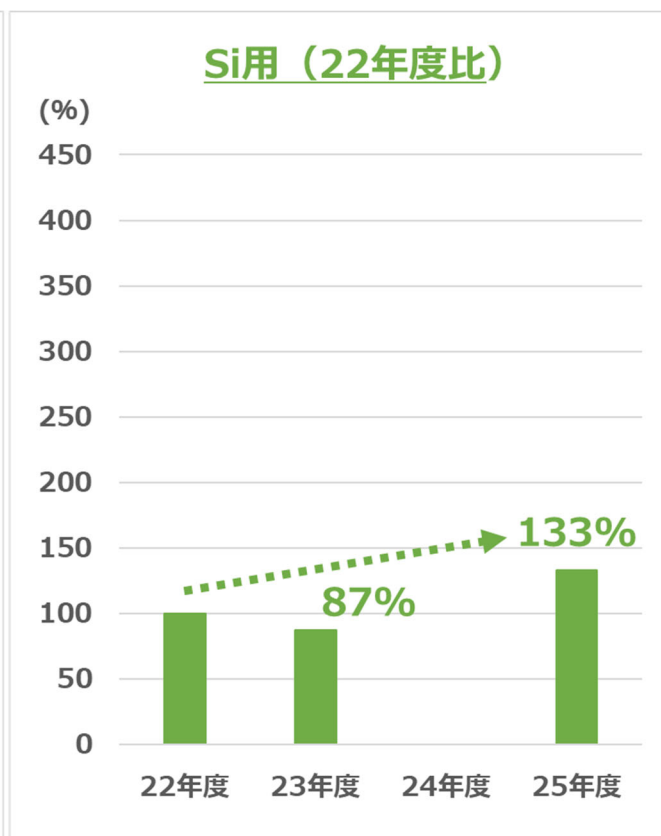
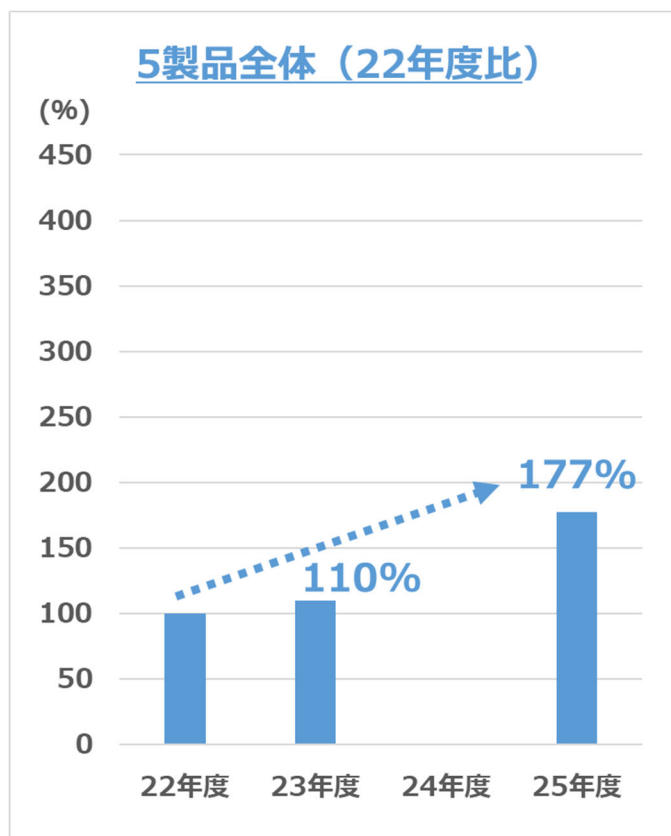
1





半導体注力

▶ 注力5製品の2025年度売上伸び率（22年度比）



なぜSiCパワー半導体が増加するのか？

▼ SiCやGaNウェーハを使用したパワー半導体が次々と製品化！！

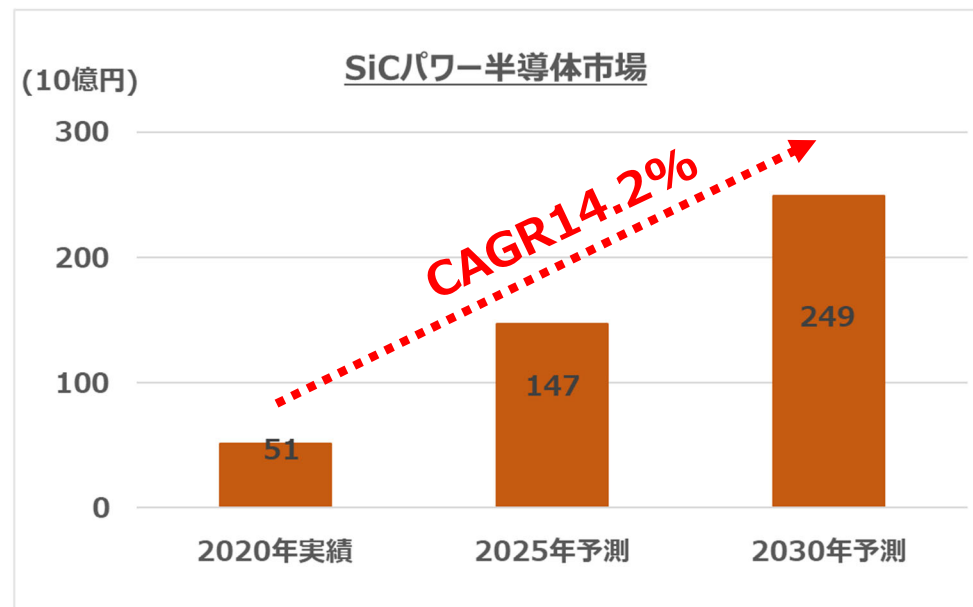
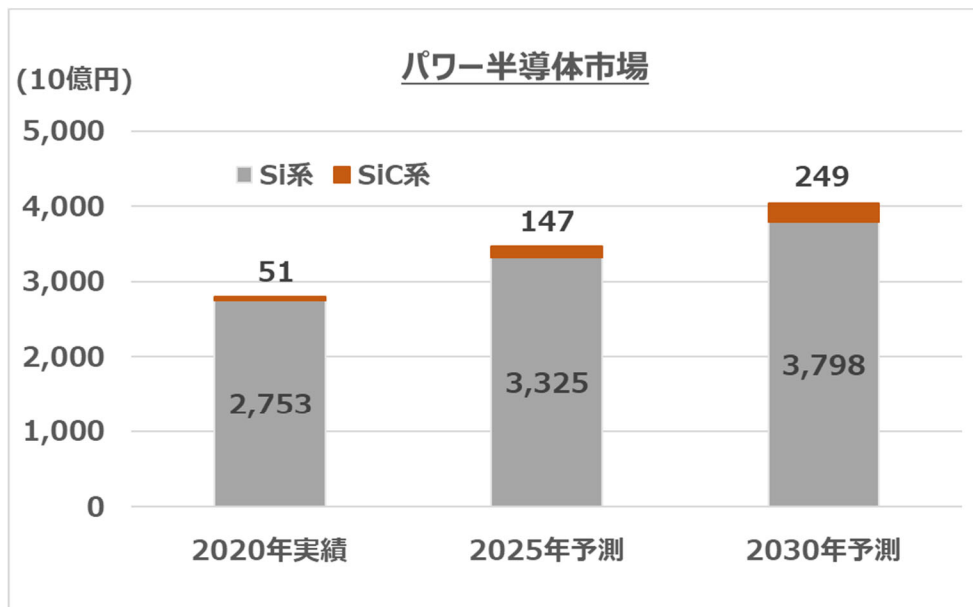
Siパワー半導体からSiCやGaNを使用したパワー半導体に変更すると

- ◆ 電力の交換効率が良くなり、電力損失が半分以下に！
- ◆ 耐熱性が高い、基板の熱伝導率も良いため高温動作が可能に！
- ◆ 冷却機構が小型化できるため、機器の小型化が可能に！



パワー半導体の市場

(出所：富士経済 2021年度次世代パワーデバイス&パワエレ関連機器市場の現状と将来展望)



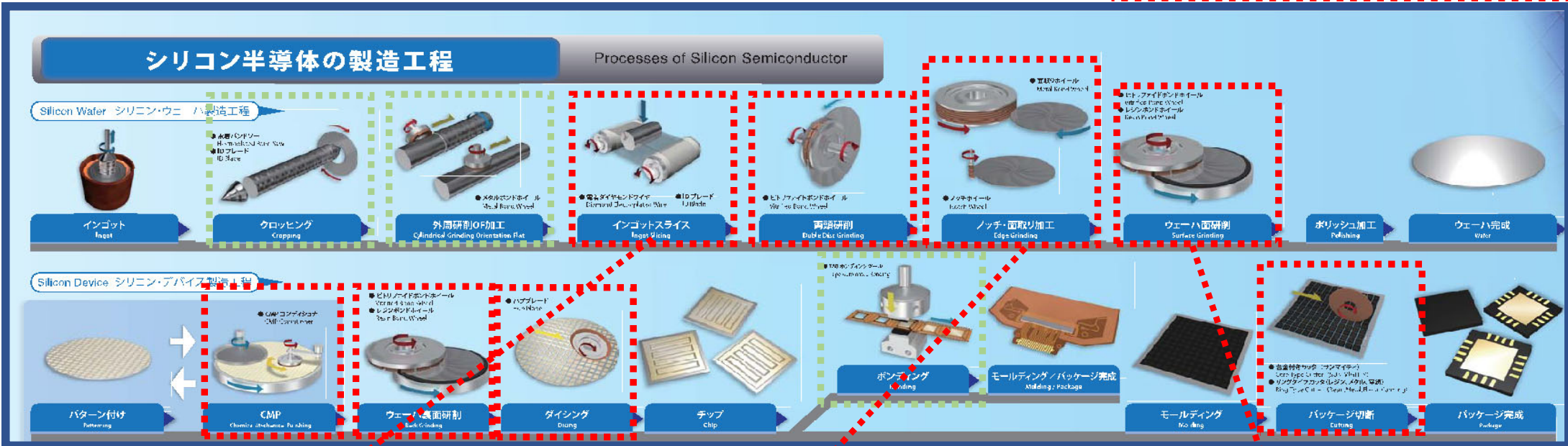
▼ Si系に比べSiC系パワー半導体市場は小さく見えるが、、、

SiCパワー半導体市場で、何でダイヤモンド工具がたくさん使用されるようになるの!?

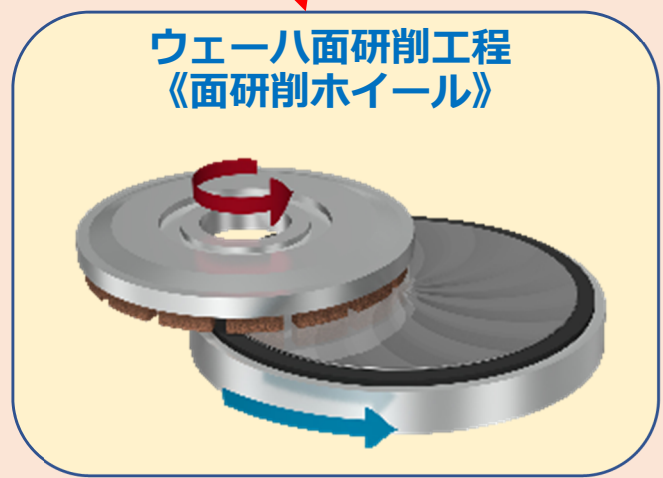
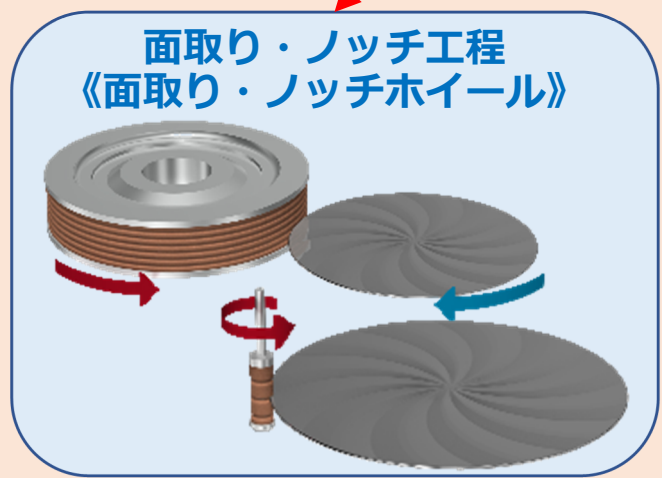
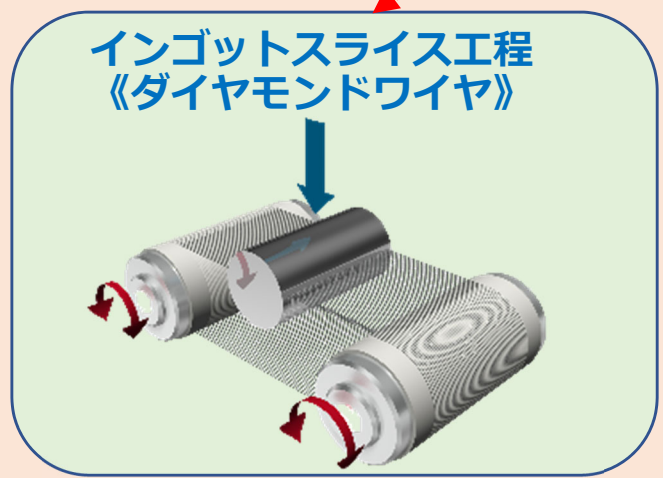
- ◆ 高い市場成長率：2030年までの年平均市場成長率CAGR14.2% (Siは3.3%)
- ◆ Siに比べ加工が難しい材料のため、ダイヤモンド工具の使用量が非常に多い

半導体の製造工程で使用されるダイヤモンド工具

赤枠は注力5製品が使用される工程



上記イラストは代表的な半導体製造工程を示しています。



SiCウェーハ製造工程で使用量の多い工具

経営基盤強化

▶ ITシステム：「経営数値の見える化」と「業務の効率化」を実現する

- 基幹システム刷新 《26年度から運用開始予定》
- 営業SFA（営業支援システム）の導入 《24年度から運用開始予定》

▶ グローバルガバナンス：中長期グループ経営方針に沿った経営の実現

- 海外子会社の事業計画に基づいた、組織・人材配置の最適化

▶ ブランディング：高品質で信頼できる旭ブランドのイメージ確立を目指す

- ホームページの刷新 《来春リリース予定》
- ブランディングチームの設置

▶ 人材育成：働きがいのある環境づくり

- 新人事制度による個々の特性を生かし成長を促進&適切な昇進昇格
- エンゲージメント調査、360度評価の実施

リソースの最適化

事業領域整理と社内外リソースの最適化

▶ グループ内最適化

- 事業領域の分析と不採算部門の整理
- 製造販売網の再編
(製造拠点の再編、インド・ベトナム販売子会社の設立)

▶ 外部リソースの活用

- 製品の外部調達
- 業務提携
(Tyrolit社との相互製品供給が進捗)

3



中期経営計画期間中の資本政策および株主還元

適用期間 2024年3月期～2026年3月期

- 配当性向50%以上
- 総還元性向120%以上（3年平均）

ROE：6%以上

PBR：1倍以上

3カ年創出キャッシュ

160億円～

純利益

減価償却費

政策保有株式の売却

資産の効率化

成長投資：150億円

株主還元：90億円

23年度上期実績

中間配当金

1株につき15円
配当性向61.3%

自己株式取得

2百万株（17億円）
7月に取得完了
11月に消却

設備投資

20億円
前年同期9億円



唯一無二 One and Only

世界の変化を先取りし、革新的技術とグローバルな組織力で、当社にしかできない製品・ソリューションを提供し続けます。

永続的な成長 Eternal Growth

モノづくりに携わる全世界のお客様から最も頼られる存在となり、永続的に成長する企業を目指します。

働きがい Job Satisfaction

仕事のやりがいを個々の成長に結び付けて持ち味を引き出し、全従業員がいきいきと働く企業を目指します。

・本資料には、過去の事実以外に今後の業績見通しや計画が記載されていますが、これらの見通しや計画は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

・2022年3月期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用しています。なお、連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

